

证券代码：688182

证券简称：灿勤科技

江苏灿勤科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

(2024年11月8日-12日)

编号：2024-013

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（线上会议、券商策略会）
参与单位名称及人员姓名	华泰证券、兴业证券、交银施罗德基金、弘毅远方基金
时间	2024年11月8日-12日
地点	灿勤科技会议室
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书：陈晨女士 证券事务代表：钱志红女士
投资者关系活动主要内容介绍	<b>第一部分：告知保密义务</b> <b>第二部分：问答环节</b> <b>1、问：公司的主营业务是什么，有哪些应用领域？</b> 答：公司主要从事高端先进电子陶瓷元器件的研发、生产和销售。产品主要包括滤波器、谐振器、天线等元器件，并以低互调无源组件、金属陶瓷结构与功能器件、射频模块与系统等多种产品作为补充。产品广泛应用于移动通信、雷达、射频电路、数据链、电子侦查与干扰、卫星通讯导航与定位、航空航天与国防科工、新能源、半导体、万物互联等领域。公司自成立以来，依托在陶瓷粉体配方和产品制备工艺领域的持续研发和经验积累，始终专注于电子陶瓷元器件的研制和开发。公司通过向客户提供高效稳定、专业可靠的元器件产品及通信解决方案，不断提升企业的品牌与价值。谢谢。 <b>2、问：公司2024年1-9月的经营业绩情况？</b> 答：公司2024年1-9月生产经营情况正常，主要财务数据及指标变动合理。

2024年1-9月，公司实现营业收入2.69亿元，较上年同期增长2.43%，实现归属于上市公司所有者的净利润5,004.19万元，较上年同期增长68.23%，实现归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3,109.74万元，较上年同期增长166.41%，主要系（1）对比的去年同期净利润基数较低；（2）公司持续开发新产品、拓展新市场，本期产品结构的变化带来盈利的能力有所提升；（3）较上年同期理财收益有所增加导致投资收益增加，以及本期存款利息增加导致财务费用减少；（4）股份支付费用同比减少，导致管理费用同比减少。

截至第三季度报告期末，公司财务状况良好，总资产25.03亿元，较上年度末增长6.48%，归属于上市公司股东的净资产21.68亿元，较上年度末增长1.54%。

2024年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额1.14亿元，较上年同期增长387.56%，主要系（1）年初至报告期末因采购账期调整导致购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅下降；（2）年初至报告期末销售商品收到的现金同比有所增加；（3）年初至报告期末支付各项税费、支付的职工薪酬等形成的经营活动现金流出同比有所下降。谢谢。

**3、问：公司的新产品应用在半导体哪些领域？目前用于半导体领域的产品订单情况怎么样？**

答：公司的HTCC电子陶瓷产品主要应用于高可靠半导体、国防科工的各类应用场景以及高频通讯移动终端，包括汽车电子、计算机、远程医疗、智能家居、高频通讯等。公司订单情况良好，具体情况请参见公司后续定期报告。公司将根据市场需求情况与客户保持密切的互动，与客户技术发展保持同步。谢谢。

**4、问：公司HTCC产品的进展情况？**

答：公司目前已建成完整的HTCC自动化设备产线，建立了HTCC产品线端到端的能力。从产品设计、陶瓷材料制备、瓷体成型、烧结、表面金属化、钎焊组装、测试检验、试验分析等可全部由公司内部完成。在HTCC陶瓷材料领域，根据不同应用场景，公司已开发出92/95/96/99氧化铝等成熟配方8种，并着手于高导热氮化铝、氮化硅陶瓷材料研发。在HTCC制造工艺领域，公司已实现单层厚度最小0.1mm，最小孔径0.1mm，最小线宽50um，最小线距50um的极限工艺能力，适用于高精度HTCC产品制造。在HTCC封装产品形态方面，公司已完成微波SIP、微波功率管壳、CMOS、光通信、光耦合器封装、CPGA、CBGA、CQFN、CLCC、CSOP、CQFP等系列封装产品的开发和送样；其中微波SIP等产品已取得客户认可，开始小批量交付使用。在陶瓷基板产品形态领域，公司数款DPC陶瓷基板已完成小批量交付验证。

公司控股子公司频普半导体目前已具备薄膜电路及相关薄膜

MEMS 无源器件的批量生产能力，部分毫米波薄膜无源器件已经开始批量生产，目前开发的新一代环形器复合陶瓷基板及半导体薄膜基板，已经开始批量生产。

控股子公司拓瓷科技的多孔陶瓷、铝基碳化硅、金属基陶瓷复合材料等相关产品线逐步丰富，应用于半导体散热基板、3C 终端壳体边框、新能源汽车轻量化制动系统的多款产品已完成送样工作，并取得了阶段性进展。谢谢。

**5、问：目前公司募投项目“新建灿勤科技园项目”进展情况如何？**

答：公司募投项目“新建灿勤科技园”项目共包含三个子项目：介质波导滤波器产能扩张项目、新建 HTCC、LTCC 产品线项目、新建电子陶瓷研究院项目。一期工程部分厂房已于 2023 年底达到预定可使用状态；二期工程目前土建已完成超过 60%；三期工程目前已拿到施工许可证，正在打桩。谢谢。

**6、问：公司的产品能用在 5.5G 基站上吗？**

答：公司最新款的陶瓷介质滤波器能够广泛适用 sub-6GHz 频段内的各应用场景，包括 4G、5G、5G-A/5.5G 等各类架构通信网络。公司将持续跟踪 5G-A/5.5G、6G 技术发展动态，做好相关的预研及技术储备，与客户保持密切的互动，跟随客户技术发展，积极参与客户的解决方案。谢谢。

**7、问：公司的产品有用到卫星上吗？**

答：公司的产品有应用于星网计划，公司长期以来参与国防科工领域重点工程，公司将与客户保持密切的互动，跟随客户技术发展。谢谢。

**8、问：高端陶瓷器件的技术壁垒主要有哪些？**

答：电子陶瓷元器件的研发、生产涉及材料科学、电子技术、机械技术、化学等众多领域，研发难度大，设计难度高，生产工艺复杂，属于典型的技术密集型产业。

**① 材料壁垒**

自有粉体配方是电子陶瓷元器件厂商的核心竞争力。电子陶瓷元器件的粉体配方必须满足高精细度、高纯度、高分散性、化学均一、高结晶度等一系列严格的技术要求，其研发过程往往需要长期的实验、检测和数据积累、分析，研发周期较长。相关配方均属于各企业的商业秘密，难以进行逆向工程和复制，行业进入者难以复制现有企业的竞争优势。

**② 工艺壁垒**

电子陶瓷元器件的生产加工需要有较强的制备能力。成熟的生产工艺依靠长期的经验积累，需要在实践中不断摸索才能取得，如生产过程中的烧结工艺、成型工艺等均需要长周期、高投

	<p>入的实践经验摸索。不成熟的生产工艺生产出的陶瓷产品容易碎裂、变形、收缩，产品的良率较低，导致生产成本更高。企业需要建立起一整套严格的工艺流程控制、检测手段，从而保证生产的标准化、系列化，从零开始积累的难度较大。厂家在工艺研发成功后，均会采用专利、商业秘密等手段加以保护，潜在竞争者很难在短期内取得能满足市场需求的高性能产品的生产工艺。</p> <p>③ 创新研发壁垒</p> <p>电子陶瓷元器件下游应用领域不断扩大，由于下游行业的快速发展，技术更新速度较快，对电子陶瓷元器件厂商的创新能力有较高的要求，上游元器件厂商需要具备独立的研发平台、先进的研发设备、较强的研发团队、较快的研发响应速度。如果缺乏较强的研发团队、自主核心技术、生产技术管理能力，将缺乏持续的研发创新能力，难以满足快速变化的市场需求，无法在市场上长期生存和发展。</p> <p>综上所述，电子陶瓷元器件行业的新进入者难以在短时间内掌握粉体配方等核心技术，生产工艺也需要较长时间的积累，在无核心技术、研发平台、研发团队的情况下难以适应市场需求的快速变化，进入壁垒较高。谢谢。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动，公司严格按照相关规定交流沟通，不存在未公开重大信息泄露等情形。
附件清单（如有）	无
日期	2024年11月12日